

携帯電話等の小型携帯機器の多様化により、超小型化、低コスト化が迫られる半導体関連パーツへのマーキング技術にも高速化、高精度の要求が高まっています。半導体に関しては超小型化、低コスト化を実現する為のアセンブリ技術も変化しており、LFMAP(LeadFlameMoidArrayPackage)の生産が増えています。LFMAPは全体をモールド後にダイシングし個片化する為、パッケージサイズがフリーで低背化、ノンリードと利点が多く、小型機器には欠かせない半導体形状といえます。当社のレーザーマーキング用ハンドラーは、LFMAPを個片化する前の工程で、マーキングが行えるよう設計されております。高精度($\pm 5 \mu$)の位置決め技術とデジタルリニアゲージ(オプション)による、外的位置保証を行い、高精度のマトリクスマーキングを実現します。



レーザーマーキング装置 外観(一例)

レーザーマーカ導入理由

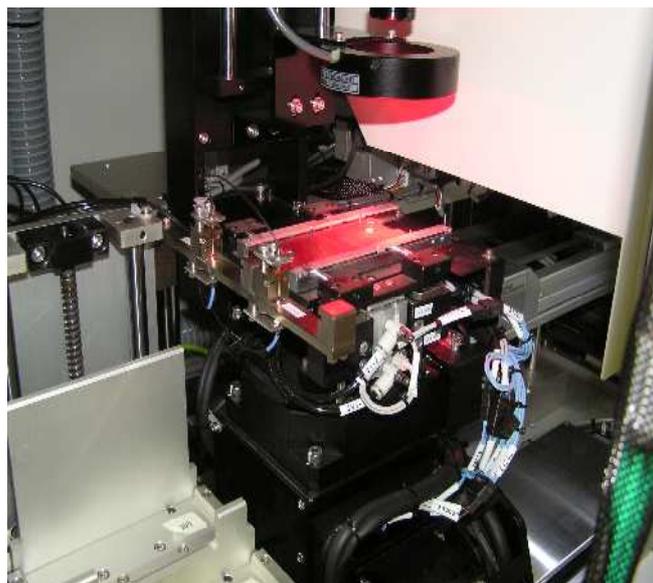
精密部品のため打刻したくない
 硬い材質のため(焼入れ鋼、超硬)のため打刻できない
 段取り換えの手間、作業モラル廃液処理上、エッチングしたくない
 消えやすい捺印、インクジェットは使いたくない洗浄すると手間がかかる
 作業環境改善のためインク印刷法は使いたくない
 樹脂リサイクル対応のためシール銘板は使いたくない
 マーキング文字が多く、小ロットの為、レーザーが良い(400文字/秒が可能)
 文字が小さく、他手法では無理(高さ0.2mm程度の微細文字が可能)
 偽造防止、他

あらゆる分野へのカスタム対応

半導体及び周辺部品等の微細部品へのマーキング、民生品・セットメーカー設備・医療・薬品・食品分野など、あらゆる製造現場で幅広く活躍しています。

レーザーマーカは、あらゆるワークへのカスタム対応で高品質、スピーディーな自動システムを実現します。さらに、マーキング後の品質検査(マーク位置ズレ、かすれ等のマーク外観)も行えます。

その他、お客様のあらゆるご要望にお答えしカスタマイズ致しますので、何なりとご用命下さい。



レーザーマーキングステージ

ご用命は、こちらに。

〒812-0893

福岡市博多区那珂5丁目3-41

協和商工株式会社

TEL(092)451-1261

FAX(092)451-1262

<http://www.ksk21.co.jp> E-mail:info@ksk21.co.jp